

证券代码：688173

证券简称：希荻微

记录编号：2025-IR-013

希荻微电子集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☒ 现场参观 ☐ 其他：_____
参与单位名称及人员姓名	【佛山抱石商业投资有限公司】：祝国杰，刘仲生 【佛山市顺德区恒科电器实业有限公司】：洪子扬 【广州泽恩投资控股有限公司】：曹盈盈 【广州市激扬企业管理咨询有限公司】：苏建鸿 【广州市摩星岭控股有限公司】：董佳宁，温文俊
时间	2025 年 11 月 6 日 15:00-16:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	【主讲人】： 唐娅 副总经理、董事会秘书、财务负责人 吴昊晟 投关经理
投资者关系活动主要内容介绍	Q：请问公司在全球范围的布局如何？ A：目前，公司总部位于佛山，在北京、上海、成都和香港设立了子公司，在深圳和西安等地设立了分公司。此外，公司在美国、韩国和新加坡设立了境外子公司，旨在加强

	与国际品牌客户的深度合作，紧密跟踪国际市场的发展趋势，进而提升公司在全球的影响力和知名度。 Q: 请问公司核心研发和管理团队的产业背景和竞争力? A: 公司以董事长 TAO HAI（陶海）博士为代表的核心研发和管理团队毕业于美国哥伦比亚大学、美国伊利诺伊大学芝加哥分校、美国华盛顿大学、新加坡南洋理工大学、清华大学、北京大学、电子科技大学等境内外一流高校，具备 Fairchild Semiconductor、Maxim、IDT、Lucent Technologies、NXP、TI、MTK、Intel、上海北京大学微电子研究院等多家业内知名企业从业经历，且最长从业年限已经超过 30 年，是一批具备国际化背景的行业高端人才，逐步带领公司成长为一家具有领先技术和强劲发展动力的创新型模拟芯片设计企业。 Q: 请问公司芯片产品在手机里面的用量及价值量? A: 目前，公司 DC/DC 芯片、锂电池充电管理芯片、端口保护及信号切换芯片、自动对焦及光学防抖芯片、Touch 触控芯片、Haptic 触觉反馈驱动芯片等多个细分品类产品均可应用于智能手机。由于不同手机客户及机型的设计需求有别，芯片用量会存在一定差异，公司芯片产品在中高端机型中的市渗透率较为可观。关于公司芯片产品的具体销售数量和销售金额，烦请关注后续年度报告的披露内容。 Q: 请问车规级芯片相较消费级芯片的区别? A: 车规级芯片相较于消费级芯片，由于应用场景环境复杂，对芯片的稳定性、可靠性、耐久性要求更高，研发过程中需 Tier 1 和主机厂配合，并通过严格测试验证才能导
--	---

	入量产，因此研发门槛更高、周期更长。 Q：请问公司车规级芯片主要客户分布在国内还是海外？ A：公司自主研发的车规级电源管理芯片产品达到了 AEC-Q100 标准，实现了向 Joynext、Yura Tech 等汽车前装厂商的出货，并最终应用于奥迪、现代、起亚、小鹏、红旗、问界、长安等中欧日韩多个品牌汽车中。 Q：请问公司音圈马达驱动芯片除手机以外能否用于大疆无人机、影石运动相机等其他搭载摄像头的应用？ A：音圈马达驱动芯片通过精准控制电流大小和方向，驱动音圈马达内的线圈在磁场中移动，从而带动镜头实现自动对焦（AF）和光学防抖（OIS）。该技术因其低成本、高响应速度、微型化设计，已成为摄像头模组自动聚焦的主流方案。公司正在加速扩展音圈马达驱动芯片的应用场景，助力该产品应用从智能手机延伸到多个领域。 Q：请问公司目前研发投入的主要方向？ A：公司研发投入的方向包括智能手机、可穿戴设备等消费电子、汽车电子及云计算等多个领域，产品类型包括电源管理芯片、端口保护及信号切换芯片等模拟芯片产品以及音圈马达驱动芯片、传感器芯片等数模混合芯片产品。 Q：请问公司目前账上的可动用资金和负债水平？ A：根据公司 2025 年第三季度财务数据，截至 2025 年 9 月 30 日，公司货币资金期末余额为 6.54 亿元，交易性金融资产期末余额为 0.86 亿元，合计为 7.40 亿元，公司资产负债率为 16.68%，处于业内较低水平，财务结构稳健。
--	---

	Q: 请问公司总部大楼的建设进度, 预计何时可以入驻? 后续规划如何? A: 公司总部基地及前沿技术研发项目作为募投项目的重要组成部分, 建成后将有效缓解当前办公与研发实验室场地紧缺的状况。公司致力于将总部基地希荻大厦打造为集技术研发和储备、量产测试、运营管理、集成电路科创中心与国际人才中心为一体的创新总部基地。2025 年 9 月 11 日, 希荻大厦已顺利完成封顶。根据公司前期披露的公告内容(公告编号: 2024-075), 公司总部基地及前沿技术研发项目达到预定可使用状态日期预计为 2026 年 6 月, 但在项目实施过程中, 仍可能存在各种不可预见因素, 导致达到预定可使用状态日期具有不确定性。 Q: 请问诚芯微车规级芯片产品的主要应用场景、客户情况及销售情况? A: 诚芯微主要聚焦汽车对外部终端设备的快速充电领域, 自主研发的车规级芯片产品通过了 AEC-Q100 认证, 是国内较早通过该项认证的模拟芯片设计企业。截至目前, 诚芯微已与比亚迪、奇瑞、长安、吉利、赛力斯、上汽、五菱、江淮和北汽等行业内知名客户建立了合作关系。2022-2024 年, 诚芯微来自汽车电子行业的收入占比分别为 6.19%、7.76%和 12.11%, 呈现快速增长的态势。 Q: 请问公司收购诚芯微项目预计何时完成? A: 根据公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》, 待相关法律程序和合同生效条件得以切实履行后, 各方会安排交割。公司正在积极、有序推进本次收购, 具体完成时间尚无法预估, 烦请关注后续公告内容。
--	--

	Q：请问公司原始股东前期减持的原因及其后续计划？ A：根据公司前期披露的公告内容，原始股东减持系基于自身资金需求，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。公司会引导原始股东有序减持，若其后续存在减持安排，公司将严格按照监管规定履行信息披露义务。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 11 月 6 日